

中国电子材料 行业协会 电子锡焊料材料分会

中电材协锡字[2024]第 08 号

关于召开中国电子材料行业协会电子锡焊料材料分会 第三十届年会暨六届一次会员代表大会的通知

会议背景

电子锡焊料材料是电子信息产业必需的消耗性材料之一，主要应用于 PCBA 制程、精密结构件连接、半导体封装等多个产业环节的电子器件的组装与互联。随着人工智能、智能网联汽车、5G 通信、云计算、物联网等新兴技术的蓬勃发展，电子锡焊料材料行业迎来了新的技术挑战和市场机遇。

2023 年以来，我国整体经济运行呈现恢复向好态势，但面临的压力仍然较大，外部环境风险挑战明显增多，国内外需求不足矛盾凸显，市场主体预期不强。从电子信息产业运行情况看，全球消费电子产品类市场消费需求持续低迷，电子锡焊料材料行业仍处于行业周期低谷，行业竞争加剧。

为增强我国电子锡焊料材料行业的交流合作，推进科技创新与产业创新的深度融合，我协会定于 2024 年 10 月 16-18 日在四川省成都市召开“中国电子材料行业协会电子锡焊料材料分会第三十届年会暨六届一次会员代表大会”。

大会将邀请电子锡焊料材料行业上下游相关企业、科研院所等围绕“产业链现状、上下游研发和应用、关键技术和发展方向”等行业热点问题开展积极广泛地交流与研讨。

- 会议主题：**赋能新质生产力，推进高质量发展
- 会议时间：**2024 年 10 月 16-18 日（16 日报到，17 日-18 日上午会议）
- 会议地点：**成都环球中心天堂洲际大饭店

（四川省成都市武侯区高新区天府大道北段 1736 号，电话：028-62758888）

四、组织机构

主办单位：中国电子材料行业协会电子锡焊料材料分会

筹备单位：深圳市亿钺达工业有限公司

广东中实金属有限公司

东莞市千岛金属锡品有限公司

五、日程安排：（以最终会议日程安排为准）

10月16日 (星期三)	10:00-22:00	会议报到
	18:00-21:00	自助晚餐
10月17日 (星期四)	9:00-9:30	开幕式及致辞
	9:30-11:30	六届一次会员代表大会 (六届理事会换届)
	11:30-12:00	会议合影
	12:00-14:00	自助午餐
	14:00-18:00	技术报告
	19:00-21:30	招待晚宴 (授牌+表彰)
10月18日 (星期五)	9:00-11:30	锡焊料技术报告+交流
	9:00-11:30	锡市场分析报告+交流
	12:00-14:00	自助午餐
	14:00-	会议疏散

六、会议收费信息

会议费：（包含会议资料费、餐费等，不包含住宿费用）

	9月30日前交费	9月30日后交费
会员单位	2,000 元/人	2,500 元/人
非会员单位	3,500 元/人	4,000 元/人

（注：已交纳 2024 年度会费的单位享受会员单位待遇）

收费账户：

开户名称：北京千喜佳业科技有限公司

开户银行：中国建设银行股份有限公司北京科创支行

银行账户：1100 1085 3000 5962 0260

七、参会须知

1、交通指南：

双流机场到酒店约 16 公里；天府机场到酒店约 60 公里；

成都西站到酒店约 22 公里；成都东站到酒店约 15 公里；

成都南站到酒店约 7 公里；成都站（成都北站）因改造暂停运营。

（注：以上各场站均可乘坐地铁到达酒店，地铁 1 号线锦城广场站 B 出口步行到酒店约 500 米）

2、报名参会：请有意向参会人员尽量提前报名，并于 2024 年 9 月 30 日前将《参会报名回执表》回复到秘书处，以便安排食宿。

3、会务组联系方式：

联系人：李红旗 13426394643（微信同号）

黄后军 13924051155（微信同号）

冯 斌 13735460565（微信同号）

电话/传真：010-62629026， E-mail：93347265@qq.com。

附件 1：年会报告内容

附件 2：参会报名回执表

中国电子材料行业协会电子锡焊料材料分会



附件 1：年会报告内容

中国电子材料行业协会电子锡焊料材料分会 第三十届年会报告内容

1、【报告：锡市场分析与趋势展望】

报告人：郭 宁 秘书长/高级工程师 中国有色金属工业协会锡业分会

2、【报告：封装材料发展趋势】

报告人：吴懿平 教授 华中科技大学材料科学与工程学院

3、【报告：通讯产品对锡基材料的新需求】

报告人：孙 磊 中兴通讯 PCBA 工艺首席专家

4、【报告：车规级组件及接点对焊料的要求】

报告人：罗道军 副院长/研究员 中国赛宝实验室元器件与材料研究院

5、【报告：数字化转型的形势及案例】

报告人：范忠辉 工业和信息化部电子第五研究所软件与系统研究院

6、【报告：高温焊料的应用前景及发展方向】

报告人：张富文 研发部经理/教授级高工 北京康普锡威科技有限公司

7、【报告：高可靠性低温焊料的进展及面临的困境】

报告人：陈 钦 研发总监 苏州优诺电子材料科技有限公司

8、【报告：数字化转型在锡焊料企业中的应用及思考】

报告人：崔 锋 总经理 广州精准机械有限公司

9、【报告：锡焊料行业中松香及衍生产品的应用趋势】

报告人：杨昌毅 总经理 桂林润鑫电子材料科技有限公司

(注：最终报告顺序以会议日程安排为准)

附件 2：参会报名回执表

**中国电子材料行业协会电子锡焊料材料分会第三十届年会
暨六届一次会员代表大会参会报名回执表**
2024 年 10 月 16-18 日·成都

公司名称					
姓 名	职务/职称	手机	办公电话	传真	E-mail
房间预订	大床房：650 元/晚·单早（ 间） 双床房：750 元/晚·双早（ 间）			备 注	提前交费者， 优先预留房间
入住日期			退房日期		
开票信息	公司名称（发票抬头）：				
	纳税人识别号：				
	开户行/账户：				
	单位注册地址/电话：				
邮寄信息	发票邮寄地址：				
	收件人及电话：				
	电子信箱（用于收取电子发票）：				

注：请于 2024 年 9 月 30 日前将《参会报名回执表》回复至电子信箱：93347265@qq.com，
或发送传真至分会秘书处(传真：010-62629026)。